

合肥新汇成微电子股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中国证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》指导精神，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，于2024年7月17日披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。2024年度，公司积极开展相关工作，持续聚焦主营业务，落实现金分红和股份回购，在推动上市公司持续优化经营、积极回报投资者、助力信心提振方面取得积极成效。

公司为能在2025年更好的延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，对2024年方案执行情况进行评估总结，并基于2024年的实际情况制定2025年的优化目标和提升举措。本行动方案已于2025年3月26日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。具体如下：

一、聚焦经营主业，深耕先进封装

公司自成立至今专注于集成电路先进封装测试业务，所封测芯片类型主要聚焦于显示驱动芯片领域，主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测

试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

2024年度，受益于下游需求企稳及可转债募投项目新扩产能逐步释放，公司出货量持续增长，营业收入同比增长21.22%，达150,101.97万元；经营活动产生的现金流量净额同比增长42.51%，达50,086.38万元。经营规模持续增长的同时，公司在盈利能力方面面临一定的挑战。

2025年，公司将继续紧抓品质和管理，提质降本增效筑牢显示驱动芯片封测领域竞争优势，同时提升产业链资源整合能力，以市场为导向、技术为支撑大力拓展产品线，丰富产品结构，为客户提供更全面、更优质的封装测试服务。具体包括以下几个方面：

1、推进扩产项目建设，巩固产能规模优势

2024年，公司完成可转债发行，募集资金114,870.00万元，主要用于加码新型显示驱动芯片封测业务，推进12吋先进制程新型显示驱动芯片封装测试产能扩充。截至2024年底，可转债募投项目投资进度已经超过60%。此外，汇成二期车规芯片项目已经开始厂房工程建设。

产能优势是公司在显示驱动芯片领域重要的核心竞争优势之一，也是公司为客户提供安全可靠封测服务供应的基础。

2025年，公司将继续全面推进以上扩产项目建设，提升AMOLED等新型显示领域和车规领域的产能配置，满足新型显示驱动芯片快速增长的市场需求。在车规芯片领域，公司将充分利用已经取得的汽车行业质量管理体系IATF 16949:2016正式认证，在加快项目工程建设的同时，积极与相关客户就车载芯片进行验证与合作，提升公司车规芯片营收占比。

2、以凸块技术为基础、以客户需求为导向，拓宽技术应用边界

公司所拥有的凸块制造工艺是实现众多先进封装工艺的关键底层技术之一，2024年，公司已经着手将凸块制造工艺从金凸块向铜镍金凸块和钯金凸块扩展，为客户对稳定性和使用寿命要求相对较低的产品提供低成本解决方案。未来将不断拓展技术边界，积极布局Fan-out、2.5D/3D等高端先进封装技术，以高端先进封装技术为基础丰富公司产品矩阵，寻求第二成长曲线。

在拓宽技术应用边界的过程中，公司始终坚持以客户需求为导向，基于产业转移的时代背景，积极响应客户新产品研发需求，并基于客户需求延伸先进封装制程，提升产业链资源整合能力，跟随市场趋势拓宽封测业务下游应用领域，力图为客户提供更全面、更优质的封测服务。

3、提升运营管理绩效，增强公司盈利能力

集成电路封装测试行业对于运营管理的精细化水平要求较高，产线、制程整合、品质、采购、厂务、关务、仓储、人力

资源等任一管理面异常都可能会对产品毛利和经营业绩造成冲击，只有不断强化内部管理、提升经营效率，才能保障持续盈利能力。

2025年，公司将进一步完善产线信息化、自动化建设，充分利用新技术、新模式提高工厂智能化水平，加强内部生产管理与资源整合，通过工艺优化、分线管理等手段提升生产效率，降低生产成本；不断优化质量管理体系和质量管控模式，加大力度开展员工技能培训，防范作业异常，稳定产品品质；同时不断提升精细化管理水平，加强内部生产管理与资源整合，通过工艺优化、分线管理等手段提升生产效率，降低生产成本，实现提质降本增效，增强公司盈利能力。

4、外延发展，布局产业链生态集群

在中国证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》和《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等政策支持下，众多上市公司选择通过并购重组提升综合竞争力。2024年，公司在聚焦显示驱动芯片封装测试主业的同时，审慎评估与主营业务相关的合作机会，积极探索通过外延式增长等方式从技术互补或市场扩张等方面来提升自身综合竞争力。

2025年，公司将进一步探索通过外延发展布局产业链生态集群的可能性，在充分考量业务布局、协同效应、创新性及独特性的前提下，积极寻找合适的领域或者标的，横向拓宽公司业务矩阵，提升公司在高端先进封装测试领域综合实力。

二、保持研发投入，培育创新土壤

公司高度重视技术创新和工艺研发，为了保持产品和服务的技术领先水平和市场竞争优势，公司持续增加研发投入。2024年研发投入8,940.69万元，占当年营业收入比例为5.96%；在营业收入持续增长的情况下，最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过6%。

2025年，公司将保持现有研发投入强度，一方面巩固凸块制造等现有核心技术领先优势，另一方面不断拓宽技术边界，基于客户需求积极布局Fan-out、2.5D/3D等高端先进封装技术。针对公司现有核心技术不断加强工艺研发，深挖先进封装护城河，保障制造稳定性，减少生产异常，提高产品良率，降低生产成本。针对横向和纵向技术边界拓展，公司将继续面向高端先进封装发展方向持续进行基础技术研发和相关工艺应用研发，在公司内部培育集成电路高端先进封装创新土壤。

三、完善公司治理，强化合规意识

1、内控体系和治理机制日趋完善

2024年，公司为进一步完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，公司对《监事会议事规则》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《外汇套期保值交易管理制度》等多项公司治理及内部控制制度进行了修订。此外，公司内审部严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求与审计委员会进行沟通，在年度和半年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告，每季度均向审

计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题，以保障公司内部控制体系处在审计委员会的密切监督之中。

2025年，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和相关指引的最新规定，结合公司实际情况，适时启动《公司章程》及相关公司治理制度的修订工作，进一步优化规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。

2、独立董事的关键作用得到凸显

2024年，公司顺利完成了董事会和监事会换届选举工作，严格按照《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的要求提名和选举第二届董事会独立董事；并且新增了《独立董事专门会议工作细则》、修订了《独立董事工作制度》，为独立董事依法履职提供必要保障。

2025年，公司董事会办公室将及时向独立董事汇报公司经营及其他重大事项，按照要求组织独立董事专门会议，为独立董事开展工作提供应有的便利，保障独立董事的知情权和特别职权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。

3、关键少数合规意识进一步强化

2024年，公司督促实际控制人、董监高等“关键少数”积极参与证监会、上交所、证监局等监管机构举办的各类培训5次以上，主要包括安徽辖区上市公司新《公司法》培训会、“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训、安徽辖区上市公司独立董事规范履职培训、安徽辖区上市公司新“国九条”1+N政策体系培训会、资本市场财务造假综合惩防专题培训等面向“关键少数”的合规培训。通过系列培训，公司实际控制人和董监高合规意识得到进一步强化。

2025年，公司将持续关注内幕信息管理、股份变动等重要事项，及时向“关键少数”传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通

1、严格落实信息披露工作，提高信息披露质量

2024年，公司信息披露各项工作平稳运行，在真实、准确、完整、及时披露公司定期报告、临时公告的同时，信息披露质量和透明度有所提升，不存在重大差错或者重大纰漏，维护了股东特别是社会公众股东的合法权益。

2025年，公司将持续加强信息披露管理工作，完善信息披露内部控制程序，加强自查自纠和多人复核机制，及时、合规地公开披露投资者关切的经营情况和重大事项，以期在上市公

司信息披露工作评价当中取得更好的评价结果和等级，牢固树立良好的资本市场形象。

2、完善多层次投资者沟通渠道，提振投资者信心

（1）定期召开业绩说明会：2024年公司按计划召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，以及向不特定对象发行可转换公司债券网上路演。通过以上活动，在业绩发布和重大事项关键时点，通过投资者线上交流活动与中小投资者和机构投资者保持常态化沟通。2025年，公司将继续定期召开业绩说明会，保障全年业绩说明会召开次数不低于4次，及时向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答。

（2）持续开展投资者交流活动：2024年公司分别于5月22日、6月20日、6月25日接待中小投资者走进上市公司，积极参加上海证券交易所组织的“走进沪市ETF成分股公司”活动，与来访投资者面对面交流公司发展战略、主营业务、行业和公司近况。2025年，公司将根据实际情况和时间安排，适时组织中小投资者来访交流活动、机构投资者现场调研活动，增进公司在市场和媒体当中的认知度。

（3）完善投资者沟通及意见反馈机制：公司始终保持投资者热线电话、投资者邮箱等沟通渠道畅通，在维护股东知情权和遵守监管合规要求的前提下合理回应“上证e互动”提问，完善投资者来电接听工作机制，耐心倾听投资者诉求，对投资者在电话中关心的重点问题进行详细解答，增强信息披露可理解

性，提高公司透明度。

五、提升公司投资价值，与股东共享公司发展成果

1、持续高比例现金分红，保障股东共享公司发展成果

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。公司牢固树立回报股东的意识，坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，重视投资者回报。

2024年6月6日，公司按照股东大会审议通过的利润分配方案完成权益分派实施工作，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际派发现金红利82,440,627.70元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.06%。

2025年3月26日公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本837,981,982股，扣减回购专用证券账户中股份总数11,910,000股后可参与利润分配的股份数为826,071,982股。以此为基数计算，合计拟派发现金红利78,476,838.29元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.12%。

两年来公司持续高比例现金分红，在综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力的前提下，兼顾投资者回报和公司发展、提升广大投资者的获得感，保障股东共享公司发

展成果。

2、完成股份回购计划，应用多种市值维护举措

2024年，公司实施完成了总金额不超过1亿元的股份回购方案。基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值合理回归，公司在2024年内实际使用9,997.78万元（含手续费、过户费等交易费用）采用集中竞价方式回购公司股份1,191.00万股。2024年利润分配预案现金分红金额和2024年实施的回购金额合计17,845.46万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为111.70%。

2025年，公司将积极关注市场行情，根据资本市场情况实施稳定股价预案。在必要的情况下，适时积极采取多种措施提振市场信心，引导公司市场价值向内在价值理性回归。公司将与广大投资者一道，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来。

六、总结

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的规划，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境变化、行业变化及公司经营状况变化等因素的影响，具有一定的不确定性。公司将密切关注相关因素变化，及时调整经营策略，努力降低风险，确保行动方案目标的实现。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司将按照要求对行动方案的执行情况进行评估和总结，

及时履行信息披露义务，始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2025年3月26日